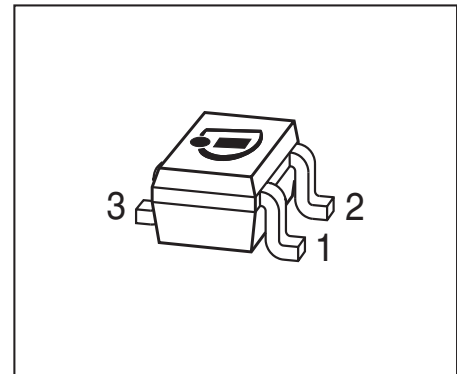


NPN Silicon RF Transistor

- For low noise, high-gain broadband amplifiers at collector currents from 1 mA to 20 mA
- $f_T = 8$ GHz, $F = 0.9$ dB at 900 MHz
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



ESD (Electrostatic discharge) sensitive device, observe handling precaution!

Type	Marking	Pin Configuration			Package
BFR182W	RGs	1=B	2=E	3=C	SOT323

Maximum Ratings at $T_A = 25$ °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	12	V
Collector-emitter voltage	V_{CES}	20	
Collector-base voltage	V_{CBO}	20	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	2	
Collector current	I_C	35	mA
Base current	I_B	4	
Total power dissipation ¹⁾ $T_S \leq 90$ °C	P_{tot}	250	mW
Junction temperature	T_J	150	°C
Ambient temperature	T_A	-55 ... 150	
Storage temperature	T_{Stg}	-55 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ²⁾	R_{thJS}	≤ 240	K/W

¹⁾ T_S is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb

²⁾ For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 1\text{ mA}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	12	-	-	V
Collector-emitter cutoff current $V_{CE} = 4\text{ V}, V_{BE} = 0$ $V_{CE} = 15\text{ V}, V_{BE} = 0\text{ V}, T_A = 85^\circ\text{C}$ (verified by random sampling)	I_{CES}	-	1	30	nA
		-	5	70	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 4\text{ V}, I_E = 0$	I_{CBO}	-	1	30	
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 1\text{ V}, I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	50	
DC current gain $I_C = 10\text{ mA}, V_{CE} = 8\text{ V}$, pulse measured	h_{FE}	70	100	140	-

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

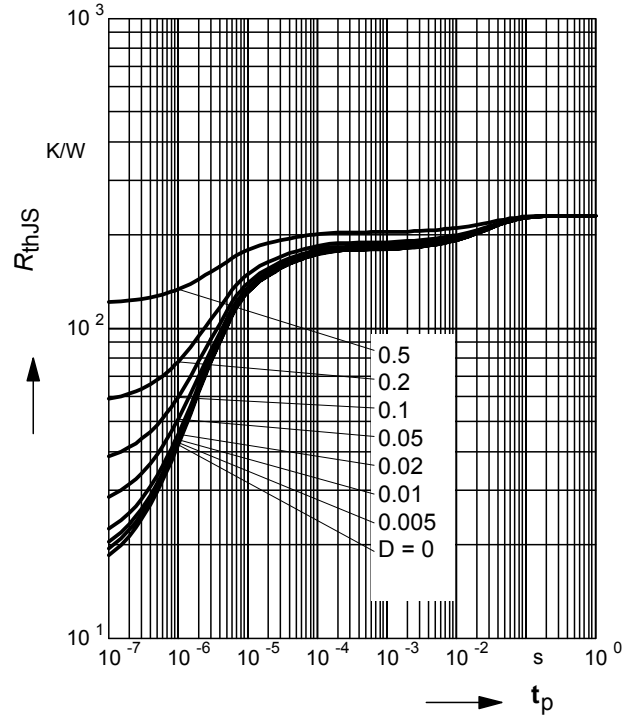
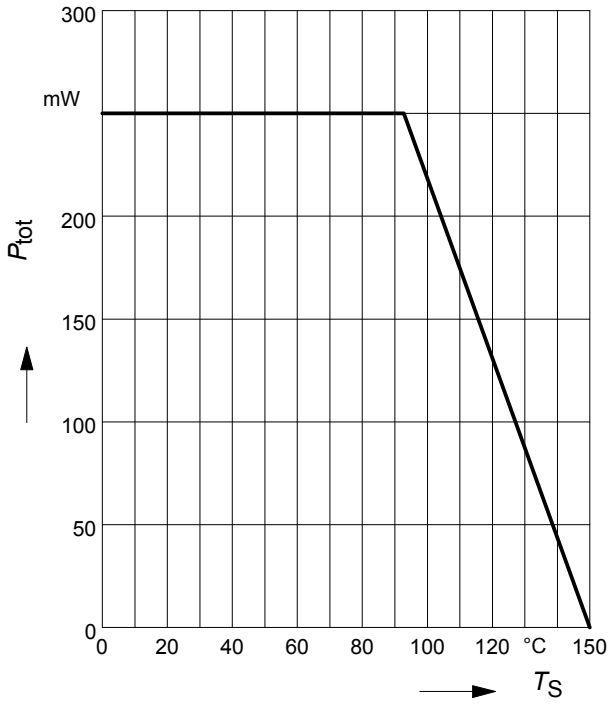
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics (verified by random sampling)					
Transition frequency $I_C = 15 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $f = 500 \text{ MHz}$	f_T	6	8	-	GHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, emitter grounded	C_{cb}	-	0.34	0.5	pF
Collector emitter capacitance $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, base grounded	C_{ce}	-	0.26	-	
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $V_{CB} = 0$, collector grounded	C_{eb}	-	0.8	-	
Noise figure $I_C = 3 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $f = 900 \text{ MHz}$ $I_C = 3 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $f = 1.8 \text{ GHz}$	F	-	0.9	-	dB
Power gain, maximum stable ¹⁾ $I_C = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$, $f = 900 \text{ MHz}$	G_{ms}	-	19	-	dB
Power gain, maximum available ²⁾ $I_C = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$, $f = 1.8 \text{ GHz}$	G_{ma}	-	12.5	-	dB
Transducer gain $I_C = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50 \Omega$, $f = 900 \text{ MHz}$ $I_C = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50 \Omega$, $f = 1.8 \text{ GHz}$	$ S_{21e} ^2$	-	15.5	-	dB
		-	10	-	

$$^1G_{ms} = |S_{21} / S_{12}|$$

$$^2G_{ma} = |S_{21e} / S_{12e}| (k - (k^2 - 1)^{1/2})$$

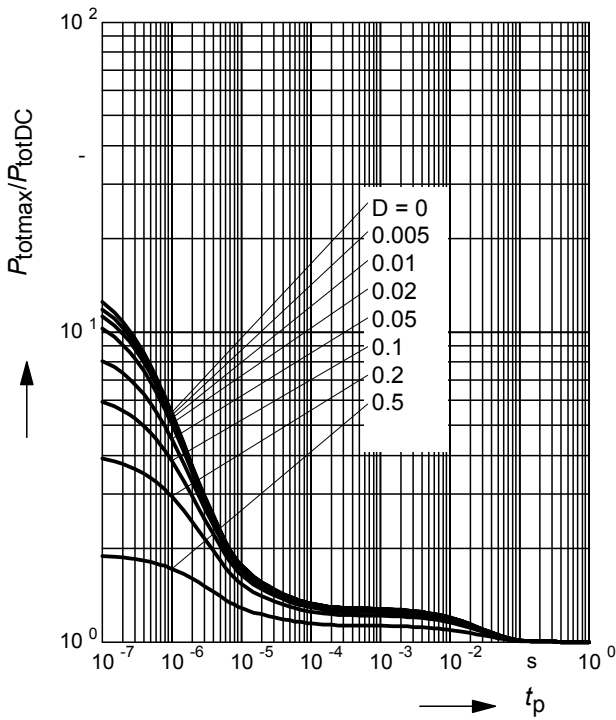
Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$



Permissible Pulse Load

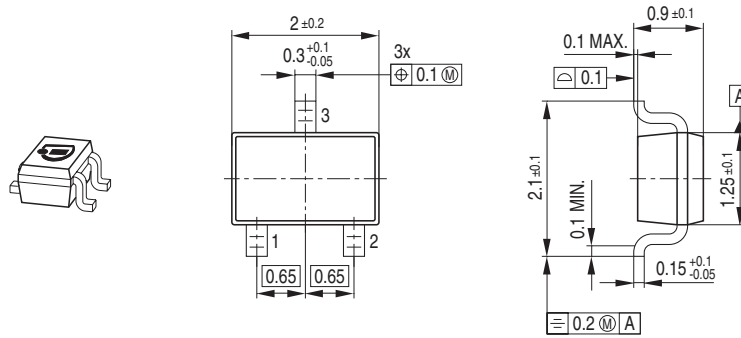
$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$



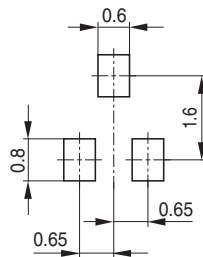
SPICE Parameter

For the SPICE model as well as for the S-parameters (including noise parameters) please refer to our internet website www.infineon.com/rf.models.

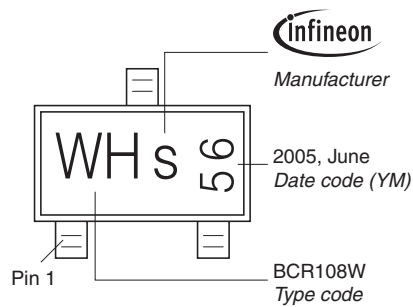
Package Outline



Foot Print

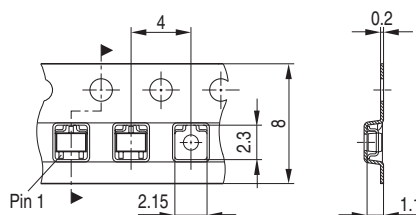


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel $\phi 180$ mm = 3.000 Pieces/Reel
 Reel $\phi 330$ mm = 10.000 Pieces/Reel



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru